



# Dry Film Solder Resist AUS SR3

## PKG 用現像型ソルダーレジスト

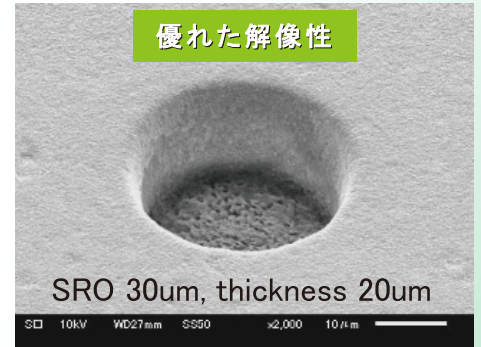
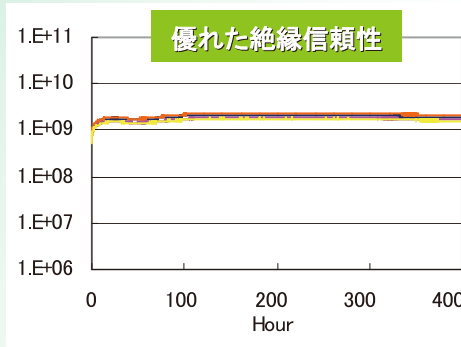
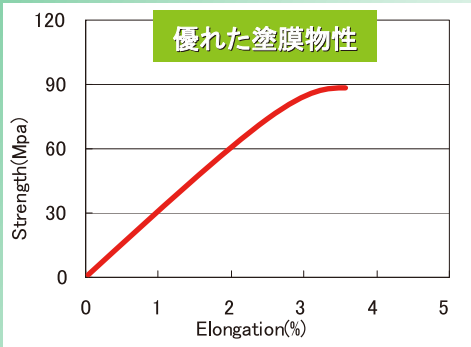
### Dry Film Solder Resist for PKG Substrate Application

#### 特徴 Features

- 高 Tg 170°C <
- 低 CTE <20ppm
- 優れた塗膜物性
- 優れた電気特性
- 優れた解像性

#### 特性 Properties

ガラス移転点 Tg *TMA method	170-175 °C
線膨張係数 CTE ( $\alpha 1$ )	<20 ppm
弾性率 Young's modulus	6.5-7.0 GPa
破壊強度 Tensile strength	85-90 MPa
破壊伸び率 Elongation	3.0-3.5 %



## Dry Film Solder Resist AUS SR2

### PKG 用現像型ソルダーレジスト

#### Dry Film Solder Resist for PKG Substrate Application

#### 特徴 Features

- 高 Tg / 低 CTE ( $\alpha 1=20-25\text{ppm}$ )
- 優れた解像性
- 優れた電気特性
- 徹底した粗粒管理

#### 特性 Properties

ガラス移転点 Tg *TMA method	145 - 155 °C
線膨張係数 CTE ( $\alpha 1$ )	20 - 25 ppm
弾性率 Young's modulus	4.5 - 5.0 GPa
破壊強度 Tensile strength	60 - 70 MPa
破壊伸び率 Elongation	2.0 - 2.5 %

## Dry Film Solder Resist AUS SR1

### PKG 用現像型ソルダーレジスト

#### Dry Film Solder Resist for PKG Substrate Application

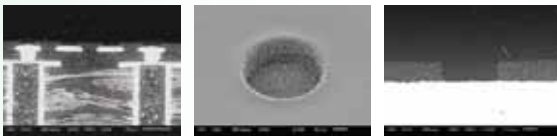
#### 特徴 Features

- 投影機 / DI 露光機対応
- 優れた塗膜物性
- 優れた電気特性
- 徹底した粗粒管理

#### 特性 Properties

ガラス移転点 Tg *TMA method	130 - 140 °C
線膨張係数 CTE ( $\alpha 1$ )	40 - 45 ppm
弾性率 Young's modulus	3.5 - 4.5 GPa
破壊強度 Tensile strength	70 - 75 MPa
破壊伸び率 Elongation	3.5 - 4.0 %

SRO 40um, thickness 20um



After 168hrs BHAST  
L/S 15/10um, 130°C/85% 12V SRO 50um, thickness 20um

